

## 性能及特性:

- 优越的耐高低温性，极好的耐气候、耐辐射及优越的介电性能
- 可返修拆卸性能
- 优越的化学和机械稳定性
- 室温或加温快速固化
- 100%固态，固化后无渗出物
- 触变性好，可自动化点胶施工

PAKCOOL® TC-225 是双组分导热硅胶填缝剂，用作电子器件冷却的传热介质。固化后与其接触表面紧密贴合以降低热阻从而更加有利于热源与其周围的散热片、主板、金属壳及外壳的热传导。本产品具有导热性能高、绝缘性能好以及触变性好等优点，可丝网印刷或者点胶成所需的形状和路径，使用灵活，可以满足不同形状和厚度的产品需求。该产品固化后与材料表面的粘结强度较低，可轻易去除方便后期维护检修。

TC-225 由膏状的 A 和 B 组分组成。A 组分呈白色，B 组分为着色液体以便混合时鉴别 A 和 B 组分是否混匀。当 A 和 B 组分以 1: 1 重量或体积比混和时，此胶可于室温下交联，加热也可提高交联速度

## 应用领域:

- LED
- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 电讯设备
- 计算机及其附件

## 注意事项:

- 接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砜、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等。
- 因为 A/B 组分的粘度略有差异，如采用机器点胶，需对两组分的压力略做调整。
- 请密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。

特性	TC-225	测试方法
基材	Silicone	--
颜色	A-白色 B-蓝色	Visual
混合比例	1:1	--
粘度 (cP)	300,000 ± 100,000	Brookfield
操作时间 (min@ 25°C)	> 30	--
导热系数(W/m·K)	2.5	ASTM D5470
硬度(Shore 00)	50±10	ASTM D2240
密度(g/ cm <sup>3</sup> )	2.95 ± 0.1	ASTM D792
介电强度 (KV/mm)	≥ 10	ASTM D149
保质期 (@0°C)	6 months	--
连续使用温度 (°C)	-50~150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

## 储存条件

- 本产品需低温储存，支装产品储存时需水平放置，使用前需要在室温下回温时间不小于 4h。

## 包装规格

- 50mL/支，200mL/支，400mL/支的包装规格

## 固化时间

- 本产品在室温下放置 12 至 48 小时即可自然固化。其交联时间将随温度升高而缩短（参见下表）。

25°C	24 小时
70°C	40 分钟

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。